

SMD-Leiterplattenklemme Pico mit Steckkontakt und Kontaktöffnungsfunktion

ohne Isolierstoffgehäuse

1-polig - 46.110.1001.48

Trichterförmiger Leitereinführkanal zur vereinfachten Leitereinführung

Direktes Stecken von eindrätigen und feindrätig, verzinneten Leitern, sowie feindrätigen Leitern durch Betätigen der Kontaktöffnungsfunktion

Kontaktöffnungsfunktion - auch zum Lösen bereits eingesteckter Leiter

Montage- und Verdrahtungsposition: Leiterplatte oberseitig

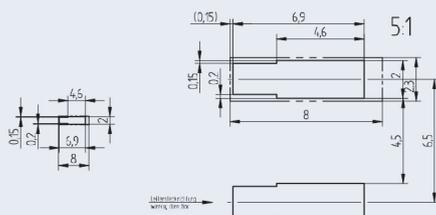
Automatengerechte "Tape-and-Reel" Verpackung

Befestigung: Bleifreie Reflow-Lötung nach DIN EN 610760-1, Abschnitt 6

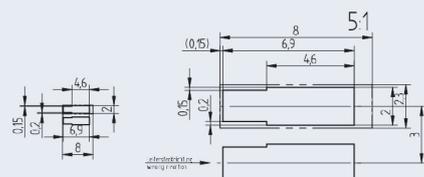
Material: CrNi / CuSn, silberfarben
 Klemmfederwerkstoff: CrNi
 Kontaktwerkstoff: CuSn
 Kontaktoberfläche: feuerverzinkt

Hinweis: Klemme ohne Isolationsgehäuse!
 Der Berührungsschutz beim Einsatz von Spannung > Kleinspannung (SELV, PELV) ist in der Anwendung sicherzustellen.

Footprint Rast 6.5 mm (630 V)



Footprint eng Rast 3.0 mm

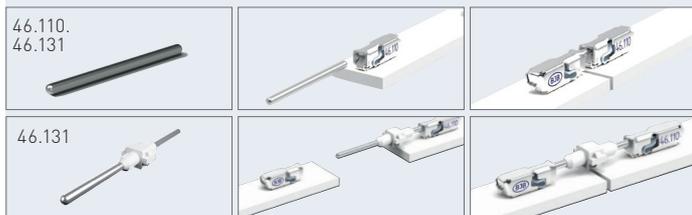


Daten zur Verpackung 46.110.1001.48	
Gewicht SMD-Klemme	0.15 g
Anzahl Klemmen pro Spule	6.000 Stück
Spulendurchmesser Gurtverpackung	330 mm - 13"
Gurtbreite	16 mm
Gewicht pro Spule	1.3 kg
Anzahl an Spulen pro Karton	18 Stück
Anzahl an SMD-Leiterplattenklemmen pro Karton	108.000 Stück
Gewicht pro Karton	22.5 kg
Abmessungen Karton (LxBxH)	400 x 355 x 365 mm



Zubehör:

SMD Pico-B2B-Verbinder. Zur Verbindung von Leiterplatten.



Werkzeug zur Kontaktöffnung

Zum Öffnen der Kontakte bei Einsatz von feindrätigen Leitern oder zur Entnahme bereits eingesteckter Leiter.



46.110.U801.89

Anschlussdaten	
Anschlusstechnik	Steckkontakt
Eindrähtige Leiter	0.20 - 0.75 mm ² , AWG 24-18
Feindrähtige, verzinnte Leiter	0.20 - 0.5 mm ² , AWG 24-20
Feindrähtige Leiter	0.20 - 0.75 mm ² , AWG 24-18
Abisolierlänge (ø < 1.55 mm) bei IMS Platinen / IMS PCBs	6.5 - 7.5 mm
Abisolierlänge	7.5 - 9.5 mm
Leitereinführung	0°
Leiterlösefunktion mittels	Werkzeug zum Kontakt öffnen
Auszugskraft nach DN 60999-1	
0.2 mm ²	min. 10 N
0.34 mm ²	min. 15 N
0.5 mm ²	min. 20 N
0.75 mm ²	min. 30 N
Einsteckkraft	max. 10 N

Geometrische Daten	
Rastermaß	6.5 mm / 0.16 inch
Breite	2.3 mm / 0.15 inch
Höhe	2.7 mm / 0.16 inch
Tiefe	8 mm / 0.52 inch

Werkstoffdaten	
Isolierstoffgruppe	-
Isolierwerkstoff	-
PTI	-
Entflammbarkeitsklasse nach UL 94	-
Klemmfederwerkstoff	CrNi
Kontaktwerkstoff	CuSn
Kontaktoberfläche	feuerverzinkt

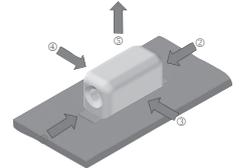
Mechanische Daten	
Montageposition	Leiterplatte oberseitig
Befestigungsart	Bleifreies Reflow-Löten

Temperaturbedingungen	
Grenztemperaturbereich	-40 °C bis + 150 °C
Umgebungstemperatur	-40 °C bis + 122 °C

Bemessungsdaten gemäß IEC / EN 60947-7-4 (IEC/EN 60664-1). Die Bemessungsdaten basieren auf dem exemplarischen Rastermaß von 6.5 mm.	
Bemessungsspannung (III / 3)	320 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	4 kV
Bemessungsspannung (III / 2)	320 V
Bemessungsstoßspannung (III / 2)	4 kV
Bemessungsspannung (II / 2)	630 V
Bemessungsstoßspannung (II / 2)	4 kV
Bemessungsstrom	9 A

Bemessungsdaten gemäß UL 1977 / CSA-C22.2 No. 182.3	
Bemessungsspannung	630 V
Bemessungsstrom	USR: 9 A AWG 24 - 18
	CNR: 6 A, AWG 24 - 20
	CNR: 9 A, AWG 18

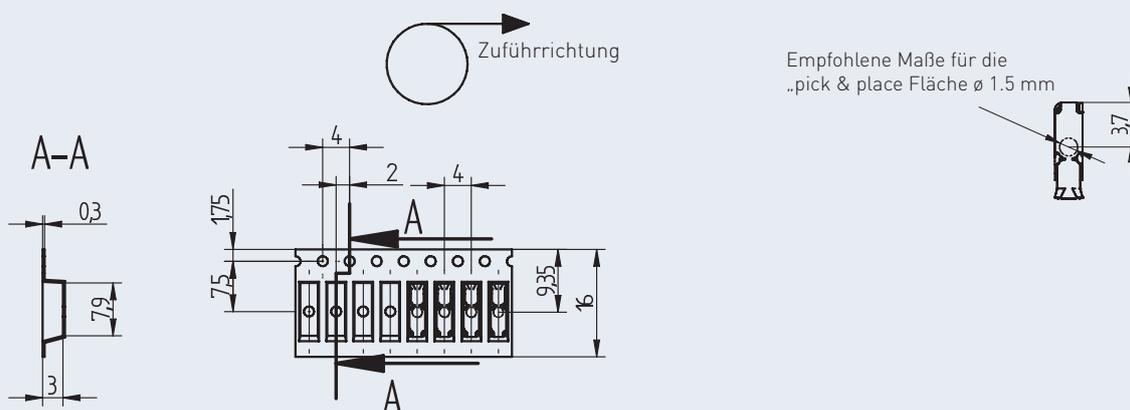
Länderspezifische Zulassungen Zertifikate	
VDE / ENEC	EN IEC 606947-7-4: 2019-10, EN IEC 60947-7-4:2019 Ausweis-Nr. 40053886
cURus	UL 1977 / CSA-C22.2 No. 182.3, File no.: E-365006

Scherkräfte nach IEC 62137-1-2.	
Bei diesen Werten handelt es sich um Maximumwerte, die nur für eine kurzzeitige Belastung gelten, nicht für Dauerbelastung.	
	
Richtung 1 Scherkraft längs	50 N
Richtung 2 Scherkraft längs	50 N
Richtung 3 Scherkraft quer	30 N
Richtung 4 Scherkraft quer	30 N
Richtung 5 Abzugskraft	30 N

Hinweise zur Verarbeitung

Geeignet für bleifreie Reflow-Lötprofile in Anlehnung an DIN EN 61760-1 bzw. DIN EN 60068-2-58 bis zu einer Peak-Temperatur von max. 260 °C. Aufgrund von unterschiedlichen anwendungsspezifischen Einflussgrößen (Bauteilanordnung und -ausrichtung, Lötanlage, Lötpaste) wird empfohlen, mittels Testläufen ein geeignetes Profil unter Fertigungsbedingungen zu ermitteln.

Abhängig vom SMD-Prozess und den Lötparametern kann eine leichte Verfärbung auftreten, welche jedoch die technische Funktionsweis nicht beeinflusst.



Lagerdauer	Lötbarkeit bei Lagerung zwischen -5°C und +40°C bei 10 - 60 %rH bis zu 6 Monaten. Bei Verarbeitung nach mehr als 6 Monaten sollte die Lötbarkeit gemäß J-STD-002D oder DIN EN 60068-2-58:2016 überprüft werden.
max. zulässige Reflow-Vorgänge	3
Lötprofil	<p>Reflow-Profil (bleifreies Löten):</p>
Lötbarkeit	Lötbarkeit der Bauteile ist durch Benetzungstest gemäß J-STD-002D geprüft
Montageverfahren	SMD, nach Zeichnung
Materialstärke SMD-Schablone	100 - 150 µm (Empfehlung BJB 150 µm)